

2009年3月期 第1四半期決算に関する補足資料

PAGE 1/2

億円未満は切り捨て表示しています

1. 決算概要

(連結)

単位:億円

	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6		2009年3月期 第1四半期 2008.4-2008.6		増減率
売上高	2,124	100.0%	1,548	100.0%	△ 27.1 %
売上総利益	765	36.0%	520	33.6%	△ 32.0 %
営業利益	430	20.3%	214	13.8%	△ 50.2 %
経常利益	411	19.4%	222	14.4%	△ 45.9 %
税前利益	424	20.0%	222	14.4%	△ 47.6 %
当期純利益	261	12.3%	128	8.3%	△ 50.9 %

2. 部門別・地域別 売上高

(連結)

単位:億円

	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6		2009年3月期 第1四半期 2008.4-2008.6		増減率
半導体製造装置					
国内	316		328		4.1 %
米国	211		189		△ 10.4 %
欧州	79		79		△ 0.3 %
韓国	214		148		△ 30.7 %
台湾	625		257		△ 58.9 %
中国	138		37		△ 72.6 %
東南アジア他	73		84		15.6 %
海外計	1,341		796		△ 40.6 %
計	1,657		1,125		△ 32.1 %
FPD製造装置					
国内	108		37		△ 65.2 %
韓国	64		63		△ 1.2 %
台湾	40		47		17.7 %
中国・東南アジア	0		23		-
海外計	105		134		27.8 %
計	214		172		△ 19.3 %
電子部品・情報通信機器					
国内	231		225		△ 2.5 %
海外	20		23		15.9 %
計	251		249		△ 1.0 %
その他					
国内	1		0		△ 29.5 %
海外	-		-		-
計	1		0		△ 29.5 %
連結合計					
国内	657		593		△ 9.7 %
海外	1,467		954		△ 34.9 %
計	2,124		1,548		△ 27.1 %

3. 事業の種類別 売上高及び営業利益

単位:億円

	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6		2009年3月期 第1四半期 2008.4-2008.6		増減率
産業用電子機器					
売上高	1,875		1,301		△ 30.6 %
営業費用	1,454		1,094		△ 24.8 %
営業利益	421		207		△ 50.8 %
電子部品・情報通信機器					
売上高	254		250		△ 1.5 %
営業費用	245		244		△ 0.8 %
営業利益	8		6		△ 24.1 %
消去又は全社					
売上高	△ 5		△ 4		-
営業費用	△ 5		△ 4		-
営業利益	0		0		48.6 %
連結					
売上高	2,124		1,548		△ 27.1 %
営業費用	1,694		1,333		△ 21.3 %
営業利益	430		214		△ 50.2 %

4. 受注高

PAGE 2/2

(連結)

単位: 億円

	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6	2009年3月期 第1四半期 2008.4-2008.6	増減率
半導体製造装置	1,452	727	△ 49.9 %
FPD製造装置	41	319	669.5 %
電子部品・情報通信機器	275	260	△ 5.3 %
その他	1	0	△ 29.5 %
合計	1,770	1,308	△ 26.1 %

5. 受注残高

(連結)

単位: 億円

	2008年3月期 第1四半期 2007.6末	2009年3月期 第1四半期 2008.6末	増減率
半導体製造装置	3,864	1,448	△ 62.5 %
FPD製造装置	479	1,417	195.6 %
電子部品・情報通信機器	164	143	△ 12.7 %
合計	4,508	3,010	△ 33.2 %

6. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結)

単位: 億円

	2008年3月期 第1四半期 2007.4-2007.6	2009年3月期 第1四半期 2008.4-2008.6	増減率
設備投資額	70	55	△ 20.9 %
減価償却実施額	46	51	10.1 %
研究開発費	148	145	△ 2.0 %

- \* 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。
- \* 利益率及び対前年増減率については、1円単位の金額をもとに計算しています。

## 2009年3月期業績予想修正に関する補足資料

### 1. 2009年3月期業績予想修正概要

億円未満は切り捨て表示しています

(連結)

単位:億円

	2008年3月期実績		2009年3月期 5/13予想		2009年3月期修正予想					
	中間期	通期	中間期	通期	中間期	中間期 利益率	対前年同期 増減率	通期	通期 利益率	対前年同期 増減率
売上高	4,763	9,060	3,000	7,000	3,015	100.0%	-36.7%	6,300	100.0%	-30.5%
営業利益	950	1,684	260	840	225	7.5%	-76.3%	510	8.1%	-69.7%
経常利益	957	1,727	280	880	250	8.3%	-73.9%	550	8.7%	-68.2%
税前利益	982	1,692	280	880	250	8.3%	-74.5%	550	8.7%	-67.5%
当期純利益	624	1,062	170	550	150	5.0%	-76.0%	330	5.2%	-68.9%
単位:円										
一株当り配当金	70	125	19	62	19	-	-	40	-	-

### 2. 部門別 売上高

(連結)

単位:億円

	2008年3月期実績		2009年3月期 5/13予想		2009年3月期修正予想					
	中間期	通期	中間期	通期	中間期	中間期 構成比	対前年同期 増減率	通期	通期 構成比	対前年同期 増減率
半導体製造装置	3,792	7,264	2,080	4,960	2,068	68.6%	-45.5%	4,205	66.8%	-42.1%
FPD製造装置	436	680	380	900	410	13.6%	-6.0%	960	15.2%	41.1%
電子部品・情報通信機器	532	1,111	535	1,130	535	17.7%	0.4%	1,130	17.9%	1.6%
その他	2	4	5	10	2	0.1%	-21.5%	5	0.1%	10.0%
合計	4,763	9,060	3,000	7,000	3,015	100.0%	-36.7%	6,300	100.0%	-30.5%

### 3. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結)

単位:億円

	2008年3月期実績	2009年3月期 5/13計画	2009年3月期修正計画
設備投資額	227	200	200
減価償却実施額	214	230	230
研究開発費	660	650	620

### 4. 期末人員 (5/13時点の予想数字から変更ありません)

単位:人

	2008年3月期実績	2009年3月期 5/13計画
国内	7,789	7,900
米国	1,281	1,250
欧州	450	450
アジア	909	900
連結計:	10,429	10,500

- \* 2009年3月期 予算作成の前提レート: US\$1=¥105
- \* 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。
- \* 利益率、対前年増減率及び構成比については、1円単位の金額をもとに計算しています。